

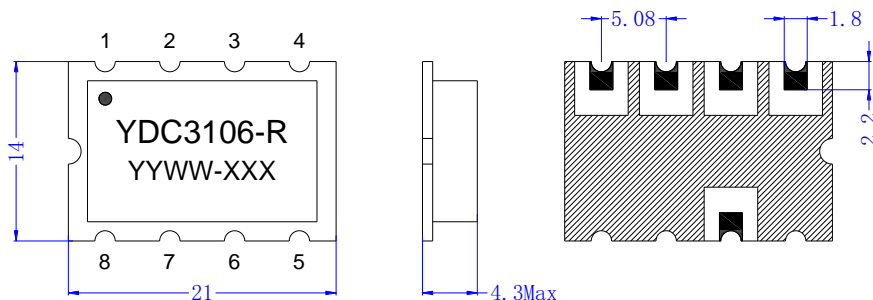
特点:

- 工作频率: 100MHz~600MHz
- 插入损耗: $\leq 0.9\text{dB}$
- 隔离度: $\geq 20\text{dB}$
- 幅度平衡: $\leq 0.3\text{dB}$
- 相位平衡: $\leq \pm 4^\circ$
- 功率容量: 10W
- 0° 四路功分器
- 封装形式: SMD 封装
- 尺寸: 21×14×4.3(max)mm

性能参数: (50Ω 系统, $P_{IN}=0\text{dBm}$, $T_A=-40^\circ\text{C}\sim+85^\circ\text{C}$)

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
工作频率	f_c		100~600			MHz	
插入损耗	IL	f=100MHz~600MHz			0.9	dB	
隔离度	ISO		20			dB	
端口驻波比	VSWR				1.5:1		
幅度平衡	AU				0.3	dB	
相位平衡	PU				4	°	

外形尺寸图:



- 注: 1、单位: mm, 未标注公差 $\pm 0.2\text{mm}$;
2、产品采用激光刻字标示。

引脚定义:

引脚编号	符号	描述
7	RFC	射频合路端口
1	RF1	射频分路端口 1
2	RF2	射频分路端口 2
3	RF3	射频分路端口 3
4	RF4	射频分路端口 4
5/6/8	GND	接地

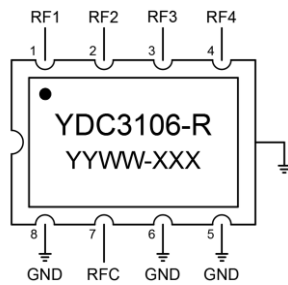
字符标志:

标识	说明	备注
●	1 脚	
YDC3106-R	产品型号	
YYWW	批次号	
XXX	序列号	

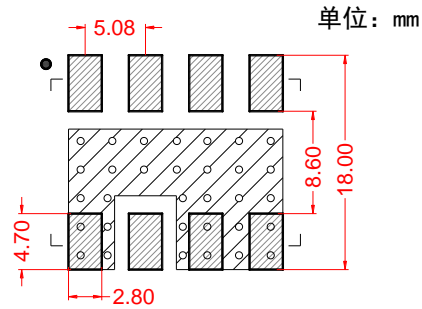
极限参数表:

参数名称	极限值
功率容量	10W
装配温度	+260℃, 20s
工作温度	-40℃~+85℃
贮存温度	-55℃~+100℃

推荐外围电路



推荐焊盘:

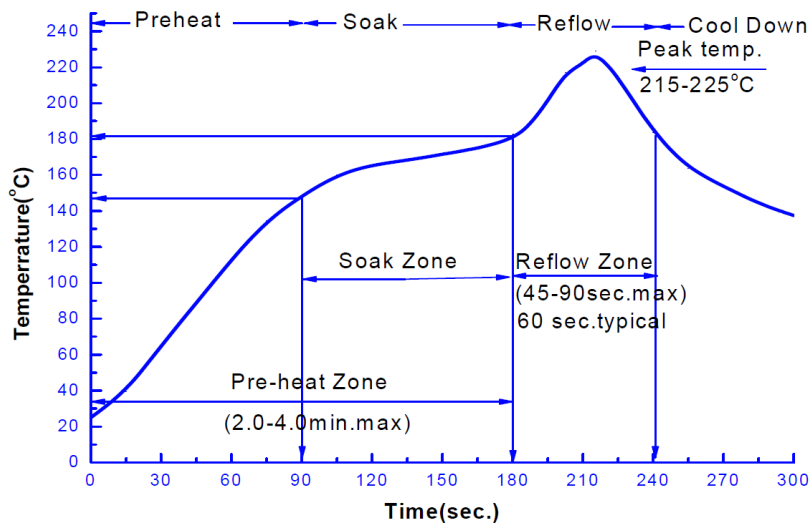


产品使用注意事项:

1. 产品在运输、装配使用过程中请注意保护引脚焊盘，防止引脚焊盘受外界应力影响而出现污损、开裂及脱落等现象；
2. 产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域），为了保证连接良好，底部引脚焊好之后，需对侧面引脚进行补焊；
3. 产品禁止采用超声波清洗，避免内部元器件及焊点受力出现开裂影响可靠性。
4. 产品属于磁性敏感器件，产品在运输、储存过程中应注意远离磁场环境，产品设计应用时应考虑强磁环境对该器件的磁性影响。



5. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 220℃。

6. 如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
7. 产品在存储时需采用防静电袋及干燥剂进行密封包装，存放条件：温度-10~+40℃，相对湿度小于 80%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
8. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。